

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“埃泰克”、“发行人”或“公司”)人民币普通股股票将于2026年4月16日在上海证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券报:<http://www.cs.com.cn/>;上海证券报:<http://www.cnstock.com/>;证券时报网:<http://www.stcn.com/>;证券日报网:<http://www.zqrb.cn/>;经济参考网:<http://www.jckb.cn/>;中国金融新闻网:<https://www.financialnews.com.cn/>;中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn/>)披露,供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:埃泰克
- (二)扩位简称:埃泰克汽车电子
- (三)股票代码:603293
- (四)首次公开发行后总股本:17,909.0658万股
- (五)首次公开发行股份数量:4,477.2665万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易,具体如下:
(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,主板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数较少的风险

公司原始股股东的股份限售期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股限售期为6个月。本次发行后,公司总股本为17,909.0658万股,其中无限售条件流通股股票数量为3,509.6511万股,占发行后总股本的比例19.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为33.49元/股,此价格对应的市盈率为:
1、21.21倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、28.29倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
3、22.29倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4、29.71倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2026年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为63.04倍。

截至2026年4月1日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	T-3日每股收盘价(元/股)	对应的2024年静态市盈率(扣非前)	对应的2024年静态市盈率(扣非后)
002920.SZ	德赛西威	3.3593	3.2599	107.25	31.93	32.90
600699.SH	均胜电子	0.6193	0.8266	25.20	40.69	30.49
002906.SZ	华阳集团	1.2409	1.2033	28.50	22.97	23.69
688326.SH	经纬恒润-W	-4.5882	-5.1559	118.39	-	-
均值					31.86	29.02

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年4月1日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注2:2024年扣非前EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
注3:经纬恒润-W 2024年扣非前后静态市盈率均为负值,因此计算均值时剔除经纬恒润-W。
本次发行价格33.49元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.71倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判

行定价的合理性,理性做出投资。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险
主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券买券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人:芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
法定代表人:CHEN ZEJIAN
地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号
联系人:李秋生
电话:0553-5675518
2、保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
保荐代表人:支音、刘森
电话:021-38966900
发行人:芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2026年4月15日

盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“盛合晶微”、“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2026]373号)。发行人的股票简称为“盛合晶微”,扩位简称为“盛合晶微”,股票代码为“688820”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司和中信证券合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.68元/股,发行数量为25,546.6162万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为7,663.9848万股,占本次发行数量的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6,938.7770万股,占本次发行数量的27.16%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额725.2078万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为15,031.3392万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.78%;网上发行数量为3,576.5000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的19.22%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共18,607.8392万股。

根据《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,128.01倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,860.8000万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为13,170.5392万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.78%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为11,852.9643万股,网下有锁定期部分最终发行数量为1,317.5749万股;网上最终发行数量为5,437.3000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.22%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03682856%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月13日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2025年修订)》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

- 1、高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的

专项资产管理计划;
2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;
3、参与跟投的保荐人相关子公司。

截至2026年4月3日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。中金公司已在2026年4月15日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	海光信息技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	99,989,840.00	12
2	中微半导体(上海)股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	99,989,840.00	12
3	上海微电子装备(集团)股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	99,989,840.00	12
4	北京摩比电科科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	99,989,840.00	12
5	沐曦(上海)科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	99,989,840.00	12
6	北京电控产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,319,105	84,989,840.00	12
7	展锐半导体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	59,989,840.00	12
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	59,989,840.00	12
9	联芯科技(杭州)股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	59,989,840.00	12
10	北京思谋微电子技术有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	49,989,840.00	12
11	唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	49,989,840.00	12
12	上海虹虹汽车电子系统有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	49,989,840.00	12
13	翱捷科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,778,455	34,989,840.00	12
14	中国中金财富证券有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	5,109,323	100,551,476.64	24
15	中金财富基金公募配售专项资产管理计划	高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	16,006,097	314,989,840.00	36
合计			69,387,770	1,365,551,313.60	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:54,198,222股
- 2、网上投资者缴款认购的金额:1,066,621,008.96元
- 3、网上投资者放弃认购数量:174,778股
- 4、网上投资者放弃认购金额:3,439,631.04元

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:131,705,392股
- 2、网下投资者缴款认购的金额:2,591,962,114.56元
- 3、网下投资者放弃认购数量:0股
- 4、网下投资者放弃认购金额:0.00元

二、保荐人(联席主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中金公司包销,中金公司包销股份的数量为174,778股,包销金额为3,439,631.04元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.09%,包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.07%。

2026年4月15日(T+4日),中金公司将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登

记至中金公司指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为24,897.30万元,明细如下:
1、保荐承销费用:19,984.61万元,上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;
2、审计及验资费:2,745.40万元,费用以工作人员的工作量为计算基础,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作情况协商确定;
3、律师费:1,590.00万元,费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付;
4、信息披露费用:535.00万元;
5、上市相关的手续费等其他费用:42.29万元
注:以上费用均已包含增值税

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620582
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:0755-23835515、0755-23835516
发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2026年4月15日

盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“盛合晶微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]373号文同意注册。《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站(www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(证券时报网,网址www.stcn.com/;中证网,网址www.cs.com.cn/;中国证券网,网址www.cnstock.com/;证券日报网,网址www.zqrb.cn/;经济参考网,网址www.jckb.cn/;中国金融新闻网/金融时报网,网址www.financialnews.com.cn/;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn/)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	0.0001美元
发行股数	本次向社会公众发行25,546.6162万股,占发行后总股本的比例约为13.71%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格(元/股)	19.68
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划参与战略配售数量为16,006,097股,占本次发行数量的6.27%;获配金额314,989,840.00元,获配计划获配股票限售期限为自发行之日起24个月	
保荐人(联席主承销商)参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售,参与战略配售数量为5,109,323股,占本次发行数量的2.00%;获配金额为100,551,476.64元,中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配股的股票限售期限为自发行之日起24个月

是否有其他战略配售安排	
发行前每股收益	0.12元(以2024年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算)
发行后每股收益	0.10元(以2024年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算)
发行市盈率	196.62倍(每股收益按照2024年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	1.94倍(按发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	8.77元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算)
发行后每股净资产	10.13元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者,询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易权限的自然人、法人等科创板市场投资者,但法律法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与投资者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	502,757.41万元
募集资金净额(万元)	477,860.11万元
本次发行费用为24,897.30万元,明细如下: (1)保荐承销费用:19,984.61万元,上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付; (2)审计及验资费:2,745.40万元,费用以工作人员的工作量为计算基础,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作情况协商确定; (3)律师费:1,590.00万元,费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付; (4)信息披露费用:535.00万元; (5)上市相关的手续费等其他费用:42.29万元 (注:以上费用均已包含增值税)	
发行人和保荐人(联席主承销商)	
发行人	盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
联系人	周燕
联系电话	0510-86975899
保荐人(联席主承销商)	中国国际金融股份有限公司
联系人	资本市场部
联系电话	010-89620561
联席主承销商	中信证券股份有限公司
联系人	股票资本市场部
联系电话	0755-23835515 0755-23835516

发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2026年4月15日